

先端技術集積地域で半導体の新たな可能を広げる 研究開発により地域再興を目指す

同社は半導体及び電子部品と生産技術の開発を通じて、世界の製造業の未来への貢献を考えている。半導体チップやDRAM、センサー、モジュールなどの実装形態に応じ、セラミック、有機、フィルムなど様々な基板材料を用い、低温低荷重のダメージフリープロセスで実現し、顧客の課題に対し、最適なソリューションを提供。製品・技術の可能性を広げ「仕事の喜び」をもって「新しい技術を創造する」ことを続けている。

●所在地 新潟県妙高市工団町3-1

●電話/FAX 025-572-7020/025-572-7120

●URL <http://www.connectec-japan.com/>

●代表者 取締役CEO 平田 勝則

●設立 2009年

●資本金 10,000万円

●従業員数 33名



低温・低荷重フリップチップ実装を可能にした半導体実装工法

IoT・ウェアラブル製品に多用される半導MEMやフィルム基板は熱に弱く、260℃はんだフリップチップ実装では劣化や変形が生じる。同社の優位性は、はんだ実装に替え80℃～170℃の低温1/20の荷重で実装できる革新的工法開発である。当技術で1m×3.5mデスクトップサイズの実装装置を実現、製造工程数は34工程から3工程に削減、コンパクトで安価な半導体実装ラインのデスクトップファクトリを実現。デスクトップファクトリの複数設置、複数事業所での所有で今後のIoT用半導体組立で必須の多品種変量生産対応を実現した。



半導体実装装置

多種多様な半導体・MEMS組立対応の実装開発ビジネスモデル構築

同社の受託実装開発ビジネスモデルの優位性は、独自の製造プロセスである低温接合で、主要工程が3工程と少なく、製造ライン切替が容易であり、多品種かつ少量～大量までの生産に対応可能である。また経験豊富な各々の開発人員が日本中の会社、技術、人をコネクティングして開発を進め、独自の低温接合に加え、顧客の要望を満たす様々な製造プロセスの提案が可能。さらに複数顧客の最先端開発の方向性を理解し数年先の未来を踏まえた開発提案が可能である。



半導体・MEMS組立の実装開発ビジネスモデル構築

先端技術集積地域の歴史的技術の延長で地域の再興を目指す

上越妙高地域は半導体製造の集積地域であったが生産の海外移転で衰退した。自身もリストラ・離職した大手半導体の元役員の前社長は、この地域でゼロから再起をめざし、世界800社を訪ねて市場を把握し、世界的新技術を元にIoT時代に対応したVBを起業した。同じ半導体分野で高度技術者の雇用を同地域で再創出中であり、競争環境変化で生じる高度技術者の雇用ミスマッチ対策と地域再活性化に取り組んでいる。



先端技術集積地の地域再興を目指す